

台灣創新技術博覽會 黃俊達張健忠獲最高榮譽發明鉑金獎及未來科技獎

學習新視界

【記者黃柔蓁淡水校園報導】化學系校友，佐信科技總經理黃俊達與中興大學特聘教授張健忠，在經濟部舉辦的2023年台灣創新技術博覽會實體展中，共同研發並取得臺灣及美國專利，「三維電漿熱點之訊號增強晶片」產品，拿下發明獎最高榮譽的鉑金獎，並榮獲未來科技獎殊榮。

經濟部為促進企業和學術機構互動，推動產業升級轉型與國際合作，於10月12至14日在臺北世界貿易中心展覽大樓展出，黃俊達與張健忠同為本校化學系畢業，張健忠續在本校化學系進修碩士及博士學位，所研發之晶片可成功應用於農藥、蘭花病毒、冠狀病毒與抗體、直接膽紅素等食安與生醫的檢測，獲今年未來科技獎的肯定。

該專利為共同持有，所開發三維空間的奈米結構之增益晶片，有別於傳統二維結構材料，不但提高靈敏度，可進而偵測低濃度樣品，且無需樣品前處理，也不需破壞樣品，樣品用量極少，團隊將該特性應用在抗體、抗原以及COVID-19相關與智慧農業檢測，成果於2023年10月被刊登在高參考價值國際知名期刊（Applied Physics Reviews），影響因子為19.527，此項發明將對未來醫療門診助益良多。



FB11

奈米級的電漿結合拉曼
造就了全新的智慧辨識系統!

Nanoscale plasma meets Raman, a new intelligent
identification system is created!

具三維電晶熱點之訊號增強晶片

Signal enhancement chip based on 3-
dimensional plasmonic hotspots (3D-PHS)

國立中央大學 智慧檢測團隊

淡江時報

2023
FutureTech
未來科技館

未來科技獎 FUTURE TECH AWARD

全方位 SERS 檢測平台CSDP-
生醫和食安應用

